

Dell EMC PowerEdge R550

기술 사양

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: 기술 사양	4
새시 크기.....	4
새시 중량.....	5
프로세서 사양.....	5
PSU 사양.....	5
지원되는 운영 체제.....	6
냉각 팬 사양.....	6
시스템 배터리 사양.....	7
확장 카드 라이저 사양.....	7
메모리 사양.....	7
스토리지 컨트롤러 사양.....	7
드라이브.....	8
포트 및 커넥터 사양.....	8
USB 포트 사양.....	8
NIC 포트 사양.....	8
직렬 커넥터 사양.....	8
VGA 포트 사양.....	8
비디오 사양.....	8
환경 사양.....	9
미세 먼지 및 가스 오염 사양.....	10
열 제한 매트릭스.....	11

기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

주제:

- 새시 크기
- 새시 중량
- 프로세서 사양
- PSU 사양
- 지원되는 운영 체제
- 냉각 팬 사양
- 시스템 배터리 사양
- 확장 카드 라이저 사양
- 메모리 사양
- 스토리지 컨트롤러 사양
- 드라이브
- 포트 및 커넥터 사양
- 환경 사양

새시 크기

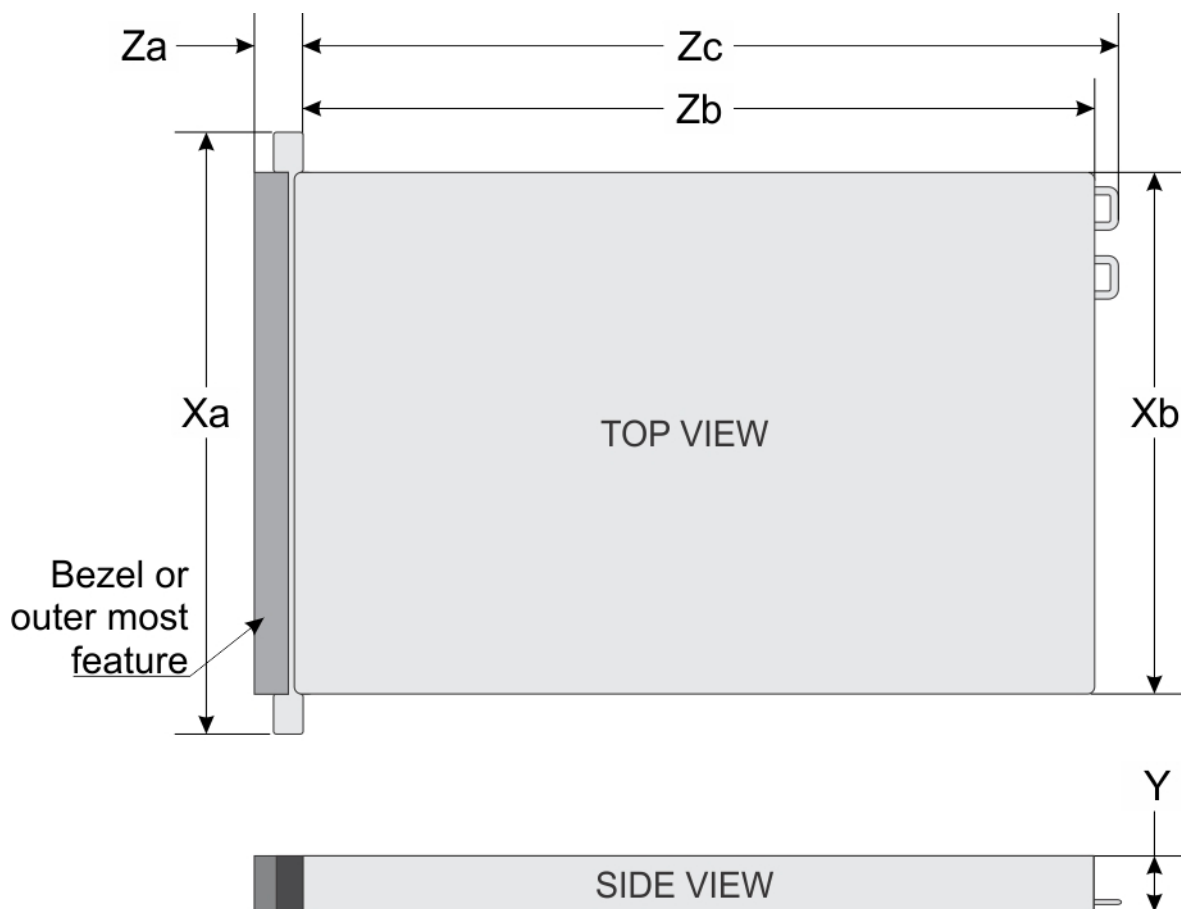


그림 1. 새시 크기

표 1. PowerEdge R550 새시 크기

드라이브	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
16개의 드라이브	482.0mm(18.97인치)	434.0mm(17.08")	86.8mm(3.41")	22.0mm(0.86") 베젤 불포함 35.84mm(1.41") 베젤 포함	675.04mm(26.57") 이어이어~L 브래킷 하우징 650.24mm(25.6") 이어~PSU 서피스	685.78mm(26.99") 이어~PSU 핸들, 벨크로 스트랩 제외
8개의 드라이브						

이 노트: Zb는 시스템 보드 I/O 커넥터가 상주하는 공칭 후면 벽 외부 표면을 나타냅니다.

새시 중량

표 2. PowerEdge R550 새시 중량

시스템 구성	최대 중량(모든 드라이브/SSD/베젤 포함)
16개의 2.5"	21.94kg(48.36lb)
8개의 2.5"	20.44kg(45.06lb)
8개의 3.5"	24.80kg(54.67lb)

프로세서 사양

표 3. PowerEdge R550 프로세서 사양

지원되는 프로세서	지원되는 프로세서의 수
3세대 인텔 제온 확장 가능 프로세서 최대 24코어	최대 2개

PSU 사양

PowerEdge R550 시스템은 최대 2개의 AC 또는 DC PSU(Power Supply Unit)를 지원합니다.

표 4. PSU 사양

PSU	등급	열 손실(최대)	주파수	전압	AC		DC	전류
					하이 라인 200~240V	낮은 라인 100~120V		
1100W DC	NA	4265BTU/hr	NA	-48~(-60)V	NA	NA	1100W	27A
800 W 혼합 모드	플래티넘	3000BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC, 자동 범위 조정	800 W	800 W	NA	9.2~4.7A
	NA	3000BTU/hr	NA	240V DC, 자동 범위 조정	NA	NA	800 W	3.8A
600 W 혼합 모드	플래티넘	2250BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC, 자동 범위 조정	600 W	600 W	NA	7.1~3.6 A
	NA	2250BTU/hr	NA	240V DC, 자동 범위 조정	NA	NA	600 W	2.9A

이 노트: 또한 이 시스템은 상간 전압 240V를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.

① **노트:** 열 손실은 PSU 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

① **노트:** 시스템 구성 선택 또는 업그레이드 시 최적 전원 활용도를 보장하려면 Dell.com/ESSA에서 Dell Energy Smart Solution Advisor를 사용하여 시스템 에너지 소비를 확인하십시오.

지원되는 운영 체제

PowerEdge R550 시스템은 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Ubuntu Canonical - Ubuntu Server LTS
- Citrix 하이퍼바이저
- Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함)
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

자세한 내용은 www.dell.com/ossupport 섹션을 참조하십시오.

냉각 팬 사양

PowerEdge R550 시스템은 최대 6개의 표준(STD) 쿨링 팬을 지원합니다.

표 5. 냉각 팬 사양

팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
표준 팬	STD	STD	레이블 없음	
고성능 팬(실버 등급)	HPR 실버	HPR	실버	<p>① 노트: 새 냉각 팬은 고성능 실버 등급 레이블과 함께 제공됩니다. 반면에 기존의 냉각 팬에는 고성능 레이블이 있습니다.</p>  <p>그림 2. 고성능 팬</p>

시스템 배터리 사양

PowerEdge R550 시스템은 CR 2032 3.0-V 리튬 코인 셀 시스템 배터리를 지원합니다.

확장 카드 라이저 사양

PowerEdgeR550은 시스템 보드에서 최대 4개의 PCI express(PCIe) 슬롯(3개의 Gen4 및 1개의 Gen3 슬롯)을 지원합니다.

표 6. 시스템 보드에서 지원되는 확장 카드 슬롯

PCIe 슬롯	확장 카드 라이저	프로세서 연결	높이	길이	슬롯 폭
슬롯 1	해당 없음	프로세서 1	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16
슬롯 2	해당 없음	PCH	로우 프로파일	HL(Half Length)	x8(x4 링크)
슬롯 5	해당 없음	프로세서 2	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16
슬롯 6	해당 없음	프로세서 2	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16

메모리 사양

PowerEdge R550 시스템은 최적화된 운영을 위해 다음과 같은 메모리 사양을 지원합니다.

표 7. 메모리 사양

DIMM 유형	DIMM 랭크	DIMM 용량	단일 프로세서		듀얼 프로세서	
			최소 DIMM 용량	최대 DIMM 용량	최소 DIMM 용량	최대 DIMM 용량
RDIMM	싱글 랭크	8GB	8GB	64GB	16GB	128GB
	듀얼 랭크	16GB	16GB	128GB	32GB	256GB
		32GB	32GB	256GB	64GB	512GB
		64GB	64GB	512GB	128GB	1TB

표 8. 메모리 모듈 소켓

메모리 모듈 소켓	속도
16개, 288핀	2933MT/s

스토리지 컨트롤러 사양

PowerEdge R550 시스템은 다음 컨트롤러 카드를 지원합니다.

표 9. 시스템의 스토리지 컨트롤러 카드

내부 컨트롤러	외부 컨트롤러
<ul style="list-style-type: none"> S150 PERC H345 PERC H355 PERC H745 PERC H755 HBA355i BOSS-S2(Boot Optimized Storage Subsystem): HWRAID 2개의 M.2 SSD 240GB 또는 480GB 	<ul style="list-style-type: none"> PERC H840 HBA355e

드라이브

PowerEdge R550 시스템은 다음을 지원합니다.

- 16개의 2.5" SAS/SATA HDD/SSD.
- 8개의 2.5" SAS/SATA HDD/SSD.
- 8개의 3.5" SAS/SATA HDD/SSD.

포트 및 커넥터 사양

USB 포트 사양

표 10. PowerEdge R550 USB 사양

전면		후면		내부(옵션)	
USB 포트 유형	CPU 수	USB 포트 유형	CPU 수	USB 포트 유형	CPU 수
USB 2.0 호환 포트	1	USB 2.0 호환 포트	1	내부 USB 3.0 호환 포트	1
iDRAC Direct 포트 (Micro-AB USB 2.0 호환 포트)	1	USB 3.0 호환 포트 USB 3.0 호환 포트	1		

이 노트: 마이크로 AB USB 2.0 호환 포트는 iDRAC Direct 또는 관리 포트로만 사용할 수 있습니다.

NIC 포트 사양

PowerEdge R550 시스템은 LOM(LAN on Motherboard)에 내장되고 선택 사항 OCP(Open Compute Project) 카드에 통합된 10/100/1000Mbps NIC(Network Interface Controller) 포트를 최대 2개까지 지원합니다.

표 11. 시스템의 NIC 포트 사양

기능	사양
LOM 카드	2개의 1GbE
OCP 카드(OCP 3.0)	4개의 1GbE, 2개의 10GbE, 2개의 25GbE

직렬 커넥터 사양

PowerEdge R550 시스템은 시스템 후면에서 1개의 카드 유형 직렬 커넥터 옵션을 지원하며, 이는 DTE(Data Terminal Equipment), 16550 호환 9핀 커넥터입니다.

선택 사항 직렬 커넥터 카드 설치 프로세스는 확장 카드 필러 브래킷과 유사합니다.

VGA 포트 사양

PowerEdge R550 시스템은 시스템 전면 및 후면 패널에서 각각 하나씩 2개의 DB-15 VGA 포트를 지원합니다.

비디오 사양

PowerEdge R550 시스템은 16MB의 비디오 프레임 버퍼를 사용하는 내장형 Matrox G200 그래픽 컨트롤러를 지원합니다.

표 12. 시스템에 지원되는 비디오 해상도 옵션

해상도	화면 재생률(hz)	색 심도(비트)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

환경 사양

i **노트:** 환경 인증에 대한 추가 정보는 www.dell.com/support/home에서 문서 자료 > 규정 정보의 *제품 환경 데이터 시트*를 참조하십시오.

표 13. 운영 기후 범위 범주 A2

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비에 직사광선을 받지 않고 10°C~35°C(50°F~95°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~21°C(69.8°F) 최대 이슬점의 80% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/300m(1.8°F/984ft)만큼 감소합니다.

표 14. 운영 기후 범위 범주 A3

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 5~40°C(41~104°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~24°C(75.2°F) 최대 이슬점의 85% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/175m(1.8°F/574ft)만큼 감소합니다.

표 15. 운영 기후 범위 범주 A4

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 5~45°C(41~113°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~24°C(75.2°F) 최대 이슬점의 90% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/125 m(1.8°F/410ft)만큼 감소합니다.

표 16. 모든 범주 간 공유된 요구 사항

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	

표 16. 모든 범주 간 공유된 요구 사항 (계속)

온도	사양
최대 온도 변화(운영 및 비운영 모두에 적용)	1시간 내 20°C*(1시간 내 36°F) 및 15분 내 5°C(15분 내 9°F), 테이프의 경우 1시간 내 5°C*(1시간 내 9°F) ① 노트: *: 테이프 하드웨어에 대한 ASHRAE 열 지침에 따르면 이는 온도의 순간 변화율이 아닙니다.
비운영 온도 제한	-40~65°C(-104~149°F)
비운영 습도 제한(항상 비응축)	5%~95% RH, 최대 이슬점 27°C(80.6°F)
최대 비운영 고도	12,000m(39,370ft)
최대 운영 고도	3,048m(10,000ft)

표 17. 최대 진동 사양

최대 진동	사양
작동 시	5Hz~500Hz에서 10분간 0.21Grms(x, y, z축 모두)
스토리지	10Hz~500Hz에서 15분간 1.88Grms(6개 측면 모두 테스트)

표 18. 최대 충격 펄스 사양

최대 충격 펄스	사양
작동 시	최대 11ms 동안 x, y, z축으로 ±6G의 연속 충격 펄스 6회입니다. 최대 11ms 동안 x, y, z축으로 ±6G의 연속 충격 펄스 6회입니다.
스토리지	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 71G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 면에 1회의 펄스)

미세 먼지 및 가스 오염 사양

다음 표는 미세 먼지 및 기체 오염으로 인한 IT 장비 손상 및/또는 장애를 방지하는 데 도움이 되는 제한 사항을 정의합니다. 미세 먼지 또는 기체 오염 수준이 지정된 제한 사항을 초과하여 그 결과로 장비 손상 또는 장애가 발생하는 경우 환경 조건을 바로잡아야 합니다. 환경을 개선하는 것은 고객의 책임입니다.

표 19. 미세 먼지 오염 사양

미세 먼지 오염	사양
공기 여과	데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다. ① 노트: 이 조건은 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터 외 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다. ② 노트: 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.
전도성 먼지	공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다. ① 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.
부식성 먼지	<ul style="list-style-type: none"> 공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다. 공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다. ① 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.

표 20. 기체 오염 사양

기체 오염	사양
구리 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 300Å/월 미만
은 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 200Å/월 미만

① **노트:** ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치

열 제한 매트릭스

표 21. 레이블 참조

레이블	설명
STD	표준
HSK	방열판
LP	로우 프로파일
FH	전체 높이

표 22. 열 제한 매트릭스

구성		8개의 2.5" SAS/ SATA	16개의 2.5" SAS/ SATA	8개의 3.5" SAS/ SATA	주변 온도
후면 스토리지		후면 드라이브 없 음	후면 드라이브 없 음	후면 드라이브 없음	
CPU TDP/cTDP	105W	2U STD HSK(STD 팬 포함)			35°C
	120W				35°C
	135W				35°C
	150 W				35°C
	165W	2U HPR HSK(STD 팬 포함)			35°C
	185W				35°C

① **노트:** 5개의 표준 팬 구성을 위해서는 팬 보호물이 필요합니다.

① **노트:** GPU는 어떤 구성에서도 지원되지 않습니다.

① **노트:** 라이저 모듈이 설치되어 있지 않은 경우 OCP 덮개가 필요합니다.

① **노트:** 단일 프로세서 구성에는 프로세서 보호물이 필요합니다.

PCIe 어댑터 카드 및 기타 슬롯 제한 사항

- 모든 슬롯에 대해 Finisar 100G QSFP28 옵티컬 트랜시버를 포함한 Mellanox CX6-DX는 지원이 가능합니다.
- Mellanox Starlord CX6 Dx DP 100GbE(QSFP56(MFS1S00-V003E) 포함)는 모든 구성에서 슬롯 1, 슬롯 3, 슬롯 6으로 제한됩니다.

표 23. 프로세서 및 방열판 매트릭스

방열판	프로세서 TDP
2U STD HSK	165W 이하
2U HPR HSK	165W 이상

ASHRAE A3 및 A4 환경 열 제한 사항

- 이중화 모드에서는 두 개의 PSU가 필요합니다. PSU 오류가 발생하면 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
- 185W 이상 프로세서 TDP는 지원되지 않습니다.
- 12개의 3.5" SAS/SATA 구성에서는 전면 스토리지가 지원되지 않습니다
- Dell에서 공인하지 않은 주변 장치 카드 및/또는 25W를 넘는 주변 장치 카드는 지원되지 않습니다.
- 최대 70°C보다 크거나 같은 OCP 트랜시버 사양은 지원되지 않습니다.
- 전송 속도가 25GB를 초과하는 OCP 카드는 지원되지 않습니다.
- PCIe SSD가 지원되지 않습니다.
- BOSS(M.2) 카드는 지원되지 않습니다.